

江苏长电科技股份有限公司

2018 年度为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、被担保人名称：长电科技（宿迁）有限公司、长电科技（滁州）有限公司、江阴长电先进封装有限公司、长电国际（香港）贸易投资有限公司、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED、星科金朋半导体（江阴）有限公司、JCET-SC（SINGAPORE） PTE. LTD.、STATS CHIPPAC PTE. LTD.。

2、对外担保累计金额：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为 347,292.34 万元人民币，无对外担保。

3、反担保情况：无

4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足全资子公司 2018 年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过 52.85 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于信用担保、保函担保、抵押担保、融资租赁担保等，具体额度如下：

- 1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 8,000 万元人民币；
- 2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 3 亿元人民币；
- 3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 15 亿元人民币；
- 4、对长电国际（香港）贸易投资有限公司担保不超过 12 亿元人民币；
- 5、对 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED 担保不超过 5 亿元人民币；
- 6、对星科金朋半导体（江阴）有限公司（JSCC）担保不超过 2 亿元人民币；

7、对 JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD. (JCET-SC) 及 STATS CHIPPAC PTE. LTD.担保合计不超过 15.05 亿元人民币。

2018 年 4 月 10 日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于本公司 2018 年度为全资子公司融资提供担保的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、长电科技(宿迁)有限公司

为本公司全资子公司,注册资本 25,000 万元人民币,主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2017 年末总资产为 89,021.68 万元人民币;净资产为 9,036.26 万元人民币;2017 年营业收入 84,487.02 万元人民币;净利润 4,515.64 万元人民币。

2、长电科技(滁州)有限公司

为本公司全资子公司,注册资本 30,000 万元人民币,主营研制、开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。

2017 年末总资产为 179,377.89 万元人民币;净资产为 70,792.61 万元人民币;2017 年营业收入 150,701.75 万元人民币;净利润 21,816.81 万元人民币。

3、江阴长电先进封装有限公司

为本公司全资子公司,母公司持股 96.488%,全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司持股 3.512%的中外合资企业,注册资本 5,100 万美元,主营半导体芯片凸块及封装测试产品。

2017 年末总资产为 303,374.91 万元人民币;净资产为 151,963.04 万元人民币;2017 年营业收入 322,406.25 万元人民币;净利润 32,193.95 万元人民币。

4、长电国际(香港)贸易投资有限公司(下称“长电国际”)

为本公司在香港设立的全资子公司,注册资本 24,800 万美元,主营进出口贸易。

2017 年末总资产 221,282.05 万元人民币;净资产为 160,364.84 万元人民币;2017 年营业收入 87,277.43 万元人民币;净利润-731.21 万元人民币。

5、JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED

为本公司全资子公司长电国际在韩国设立的全资子公司，主营高端封装测试产品，主要进行高阶 SiP 产品封装测试。

2017 年末总资产为 46,612.87 万美元，净资产为 21,521.63 万美元；2017 年营业收入 75,555.39 万美元，净利润 2,272.24 万美元。

6、STATS CHIPPAC PTE. LTD.

为本公司间接持股 100% 的子公司，主营半导体封装设计、凸焊、针测、封装、测试和布线解决方案提供商，全球集成电路封测外包公司。

2017 年末总资产为 209,046.18 万美元，净资产为 83,307.49 万美元；2017 年营业收入 116,062.51 万美元，净利润-8,909.00 万美元。

7、星科金朋半导体（江阴）有限公司

为本公司间接全资子公司，注册资本 30,000 万美元，主营集成电路研究、设计；BGA、PGA、CSP、MCM 等先进封装与测试，并提供相关的技术服务。

8、JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD.

为本公司间接全资子公司，注册资本 950,754,919 美元，为投资公司。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2018 年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。

四、董事会意见

本公司现有担保均为向下属全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。

五、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为全资及控股子公司累计担保余额为 347,292.34 万元人民币，无对外担保。

本公司无逾期担保。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一八年四月十一日